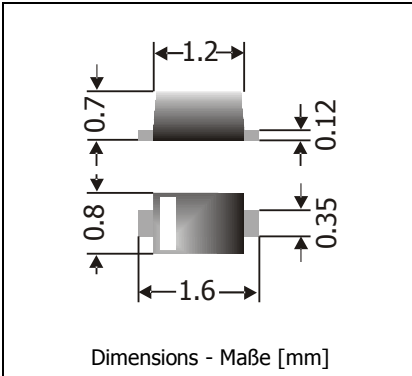


**BAS216WT**  
**Fast Switching Surface Mount Si-Planar Diodes**  
**Schnelle Si-Planar-Dioden für die Oberflächenmontage**

Version 2010-11-30



Power dissipation – Verlustleistung	150 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	85 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse	SOD-523
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	



**Maximum ratings (T<sub>A</sub> = 25°C)**

**Grenzwerte (T<sub>A</sub> = 25°C)**

	<b>BAS216WT</b>	
Power dissipation – Verlustleistung	P <sub>tot</sub>	150 mW <sup>1)</sup>
Max. average forward current – Dauergrenzstrom (dc)	I <sub>FAV</sub>	150 mA <sup>1)</sup>
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	t <sub>p</sub> ≤ 1 s I <sub>FSM</sub> t <sub>p</sub> ≤ 1 μs I <sub>FSM</sub>	0.5 A 2 A
Repetitive peak reverse voltage – Periodische Spitzensperrspannung	V <sub>RRM</sub>	85 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T <sub>j</sub>	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T <sub>s</sub>	-55...+150°C

**Characteristics (T<sub>j</sub> = 25°C)**

**Kennwerte (T<sub>j</sub> = 25°C)**

Forward voltage <sup>2)</sup> Durchlass-Spannung <sup>2)</sup>	I <sub>F</sub> = 1 mA	V <sub>F</sub>	< 715 mV
	I <sub>F</sub> = 10 mA	V <sub>F</sub>	< 855 mV
	I <sub>F</sub> = 50 mA	V <sub>F</sub>	< 1.0 V
	I <sub>F</sub> = 150 mA	V <sub>F</sub>	< 1.25 V
Leakage current Sperrstrom	T <sub>j</sub> = 25°C V <sub>R</sub> = 75 V	I <sub>R</sub>	< 1 μA
	T <sub>j</sub> = 150°C V <sub>R</sub> = 25 V	I <sub>R</sub>	< 30 μA
	T <sub>j</sub> = 150°C V <sub>R</sub> = 75 V	I <sub>R</sub>	< 50 μA
Max. junction capacitance – Max. Sperrschichtkapazität V <sub>R</sub> = 0 V, f = 1 MHz		C <sub>T</sub>	1.5 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug I <sub>F</sub> = 10 mA über/through I <sub>R</sub> = 10 mA bis/to I <sub>R</sub> = 1 mA		t <sub>rr</sub>	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R <sub>thA</sub>	< 620 K/W <sup>1)</sup>

1 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss  
 2 Tested with pulses t<sub>p</sub> = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t<sub>p</sub> = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

